

SOB-S Series

상부 설치를 통해 공간 전체의 제전이 가능합니다. 슬림·경량으로 다양한 환경에서 사용가능하며, 방전침 청소 Brush와 탈착형 루버 커버를 적용하여 유지 보수가 간편합니다.

Key Features

- 상부에 설치해 공간 전체를 제전
- 2Fan (SOB-2S), 3Fan (SOB-3S), 4Fan (SOB-4S), 5Fan (SOB-5S)으로 다양한 환경에 적용
- 자동 이온 밸런스 조절 기능
- 슬림 사이즈, 경량화, 저소음
- 자동 침 청소 기능으로 편리한 유지 보수
- Fan Speed 조절 가능 (4단계)
- 자동화 설비(PLC, RS485)와 Interface 가능
- 이온 밸런스 / Fan 이상 시 Buzzer 알람



SOB-2S



SOB-3S



SOB-4S



SOB-5S

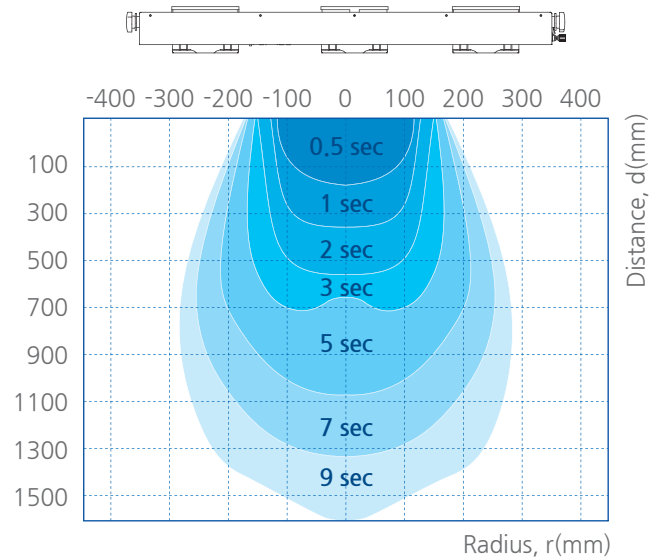
Specifications

Parameter	Description / Value				Remarks
	SOB-2S	SOB-3S	SOB-4S	SOB-5S	
Input Power	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz				
Power Consumption	37W	47W	60W	75W	Fan Speed Max.
Current Consumption	168mA	213mA	272mA	341mA	AC 220V
Ion-Generation Method	Steady-State DC				
Air Flow	8.5m ³ /min	12.75m ³ /min	17m ³ /min	21.25m ³ /min	Fan Speed Max.
Noise Level	63dB	64dB	65dB	67dB	1,000mm, Fan Speed Max.
Ion Balance	within $\pm 5V$ (600mm, Maximum Air flow)				
Operation Circumstance	0°C~+50°C (32°F~122°F), 35%~85%RH				
Ozone(O3) Concentration	≤ 0.05 ppm				
Main Body Material	Aluminum				
Electrode Material	Tungsten				
Weight	3.1kg	4.1kg	5.2kg	6.kg	
Function	4 Step Fan Speed, Tip Cleaning, Auto Tip Cleaning				
Alarm Function	Ion Unbalance Alarm, Fan Alarm				
Interface	Remote On/Off, Run State, Alarm, Tip Cleaning, RS 485				
Warranty	1 year				

※ 디자인 및 제품 사양은 품질향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

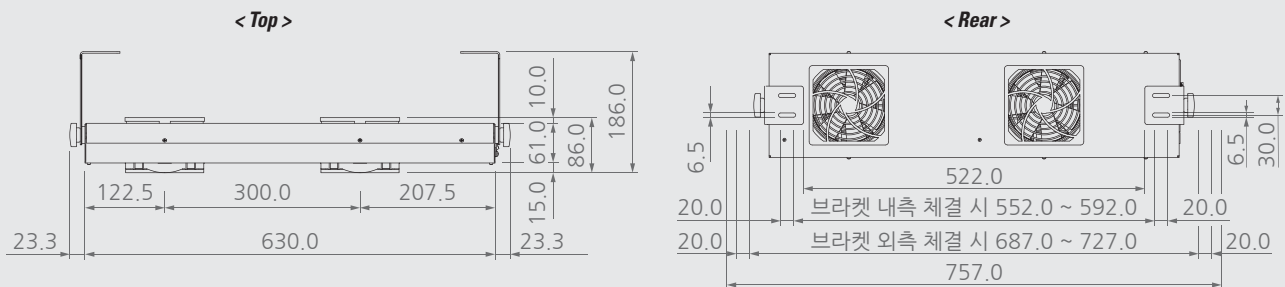
Decay Time Characteristics

- Model : SOB-3S
- Decay Time : $\pm 1,000\text{V}$ to $\pm 100\text{V}$
- Charge Plate Capacitance : 20pF ($150 \times 150 \text{ mm}$)
- Temperature & Humidity : 24°C , $50\%\text{RH}$

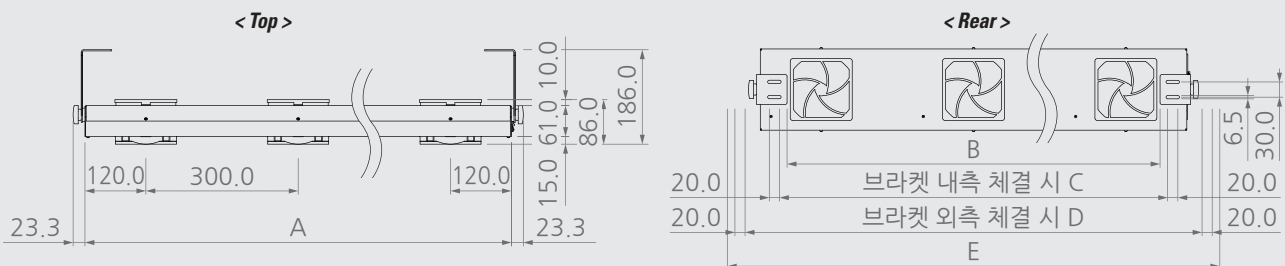


Dimensions

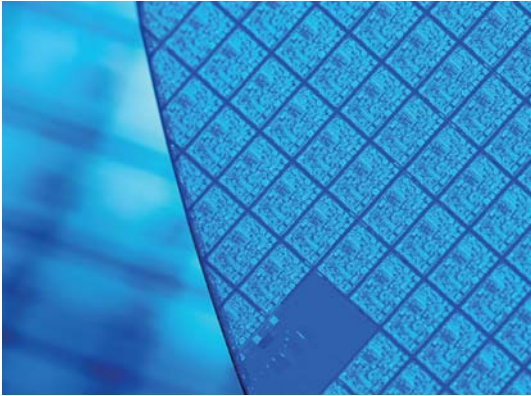
► SOB-2S



► SOB-3S / 4S / 5S



No.	Model No.	A	B	C	D	E
1	SOB-3S	840	732	762~802	897~937	967
2	SOB-4S	1140	1032	1062~1102	1197~1237	1267
3	SOB-5S	1440	1332	1362~1402	1497~1537	1567



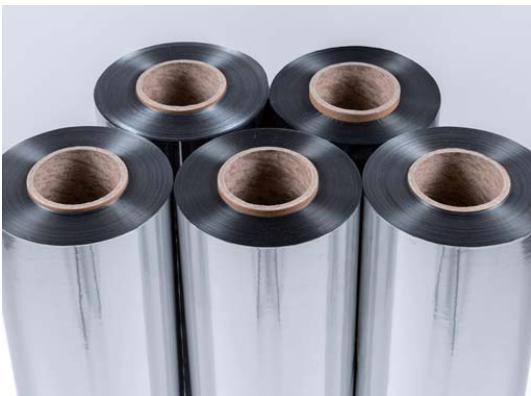
Semiconductors

반도체의 소형화 및 회로 집적도 증가로 인해 반도체는 정전기에 더욱 취약해졌습니다. 정전기는 반도체 내부 회로를 손상, 파괴하거나 장치 결함을 유발하므로 정전기 제거는 필수입니다.



Liquid crystal / Organic EL displays

액정 및 유기 EL 디스플레이의 크기와 해상도가 계속 증가하는 만큼 생산 공정에서도 많은 정전기 문제가 발생하고 있습니다. 더 넓어진 표면적에서 얼마만큼 빠르게 정전기를 제거하느냐는 생산 수율과 직결되는 부분이라 매우 중요한 요소입니다.



Films

필름과 롤러의 압력과 마찰에 의해 발생하는 정전기는 불꽃을 발산하여 필름을 손상(천공)시키거나 이물질 부착, 후가공 시 작업 효율의 하락, 정전기 쇼크로 인한 안전 문제 등을 일으킵니다. 특히 권취 및 권출 시 수십만 kV의 정전기가 발생하는데 선재의 정전기 제거 장치는 이러한 열악한 조건에서도 정전기를 중화시킬 수 있습니다.



Plastic injection molding

플라스틱 사출 성형 시 마찰과 박리로 인해 많은 양의 정전기가 발생합니다. 이때 발생한 정전기는 사출성형기 내 이물질을 부착하게 해 불량률 유발하며 성형품이 금형에서 분리되지 않게 만들어 수시로 작업자가 분리해야 하는 공수 증가 등 생산 수율 및 효율을 악화시킵니다. 정전기 제거 장치를 사용하면 이러한 문제점을 해결할 수 있습니다.



Powder

분말 입자들의 마찰로 인해 발생한 정전기는 분말 입자를 투입구 및 용기에 부착하게 만들어 균일한 양으로 포장하는 것을 방해해 생산 효율 및 수율 저하의 원인이 됩니다. 또한 상황에 따라 폭발 사고 등의 심각한 결과를 초래하기도 합니다. 선재의 광조사식 정전기 제거 장치는 분말 입자와 같이 공기 흐름이 없어야 하는 곳의 정전기 문제를 해결할 수 있습니다.



Printing

종이와 필름에 대전된 정전기로 인해 잉크 번짐, 잉크 비산, 분말 도포 불균일, 용지 2장 이송, 용지 이송 중 부착, 용지 막힘, 용지 정렬 오류 등 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 순차적으로 진행되는 인쇄 공정상 한 공정에서라도 정전기 문제가 발생한다면 차후 공정에도 영향을 끼쳐 시간·금전적인 손해가 일어날 수 있습니다.



Rechargeable Batteries

이차 전지를 생산하기 위해서는 드라이 클린룸 및 습도가 낮은 환경은 필수입니다. 이러한 환경은 정전기가 발생하기 쉬우므로 정전기를 중화시키기 위한 대책이 필요합니다. 선재의 정전기 제거 장치는 분리막 필름 손상(천공) 및 이물 부착을 방지해 제품 결함은 낮추고 수율은 높일 수 있습니다.



Coating / Painting

코팅 / 도장은 금속 및 플라스틱 자동차 부품을 비롯한 수많은 응용 분야에서 활용됩니다. 코팅 / 도장 과정에서 발생하는 정전기는 재료가 번지거나 비산되는 원인이 될 수 있으며 이물을 부착시켜 품질을 저하할 수 있습니다. 또한 공정 특성상 다량의 가연성 가스를 포함하고 있어 상황에 따라 폭발 사고 등의 심각한 결과를 초래하기도 합니다. 선재의 정전기 제거 장치는 이러한 문제를 방지하고 품질을 향상할 수 있습니다.